

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-009

深圳市民德电子科技股份有限公司 2024 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：7,500 万元-9,500 万元	盈利：1,255.57 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：9,300 万元-11,300 万元 比上年同期下降：431.98%-546.38%	亏损：1,748.19 万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2024 年，公司信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，为公司持续贡献稳定经营性现金流。公司功率半导体产业链，目前核心环节处于产能爬坡阶段，受固定资产折旧和销售尚未起量影响，短期业绩承压；但伴随核心环节产销量稳步提升，经营业绩有望逐季改善。

公司 2024 年度业绩较上年同期相比变动的主要原因为：

1、报告期内，公司信息识别及自动化产品业务保持稳健增长，AiDC 业务新产品和客户拓展顺利，收入和利润相比上年同期均实现两位数以上增长，创历史最好业绩，且为公司持续贡献稳定经营性现金流。

2、报告期内，联营企业晶圆代工厂广芯微电子产能稳步提升，包括 45V-200V 全系列 MOS 场效应二极管、200V-2,000V 全系列高压/特高压 VDMOS 等产品线已量产；报告期内，因广芯微电子处于产能爬坡阶段，单位固定成本较高，且 2024 年开始计提固定资产折旧费用，净利润较上年同期减少较大。报告期内，联营企业晶圆原材料生产企业晶睿电子外延片销量较上年同期有所增长，8 英寸外延销

量及占比提升明显，SOI、MEMS 传感器用双抛片等高价值新产品销量快速提升，SiC 外延也正式量产，收入同比增长明显，但产品单价仍处于低位，毛利率同比下降。联营企业超薄背道代工厂芯微泰克产销量稳步提升，但因处于产能爬坡阶段，固定资产折旧等单位固定成本较高。公司对上述联营企业按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期下降明显。

公司目前已完成对广芯微电子部分股权收购，持有其 50.1%的股份，广芯微电子已成为公司控股子公司；后续，公司也将为广芯微电子提供包括资金支持在内的更多平台资源支持，助力广芯微电子不断提升产能和市场竞争能力。

3、报告期内，功率半导体设计公司广微集成在新的晶圆代工厂广芯微电子，实现 45V-200V MOS 场效应二极管（MFER）全系列产品线量产，并陆续获得大客户验证通过，开始批量出货；报告期内，因新工厂产能处于爬坡阶段，且产品重新进行客户验证需要一定周期，广微集成 MFER 销量较少，在市场价格并未明显回暖的情况下，导致广微集成的收入及利润下降，但在手订单已逐步增加。同时，根据初步测算，公司预计对收购广微集成所形成商誉计提部分减值。

4、报告期内，全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调整，电池业务市场需求低迷，收入和毛利率同比下降，并计提了较大金额的信用减值损失和资产减值损失，导致净利润较上年同期下降明显；同时，根据初步测算，公司预计对收购泰博迅睿所形成商誉账面价值余额全额计提减值，而泰博迅睿原股东将对本报告期内计提的公司收购泰博迅睿所形成的商誉减值进行全额补偿，该部分补偿款收入属于非经常性损益，因此对公司扣除非经常性损益后的净利润也造成一定影响。

5、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 1,900 万元，主要为泰博迅睿资产减值补偿款。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司相关资产减值测试等工作尚在进行中，本次业绩预告相关金额为初步测算结果，最终具体数据以审计结果为准。

2、公司将在 2024 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日